

TIF™ 100-25 是一种软硅凝胶间隙填充垫。这硅凝胶混合了填料，加上独特配方，使其拥有良好导热性能，亦保留了其极软的特性。因为**TIF™ 100-25**比一般的导热硅油的粘度为高，它能防止粘合剂与填料分离的现象。另外它的粘合力偏移也比传统的散热垫控制得好。**TIF™ 100-25**的使用方法跟散热脂类似，可使用商业上一些方法包括丝网印刷，注射或自动化设备操作。**TIF™ 100-25**的应用包括倒装芯片微处理器，PPGAs，微型BGA封装，BGA封装，DSP晶片，圆形加速晶片，LED照明和其他高功率的电子元件。

特性

- 》良好的热传导率: 2.5W/mK
- 》柔软,与器件之间几乎无压力
- 》可轻松用于点胶系统生产

应用

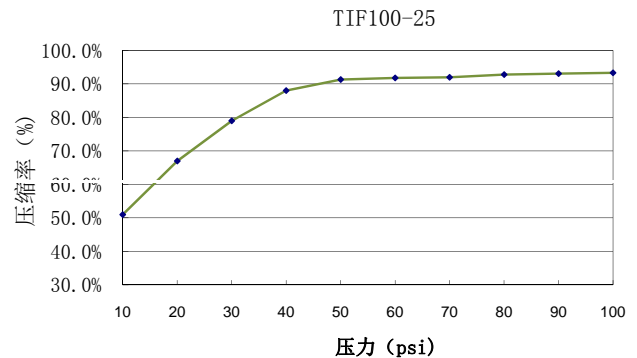
- 》散热器底部或框架
- 》LED液晶显示屏背光管 · LED电视LED灯具
- 》高速硬盘驱动器
- 》微型热管散热器》汽车发动机控制装置
- 》通讯硬件》半导体自动试验设备

TIF100-25 系列特性表					
颜色	紫色	Visual	击穿电压(T= 1mm 以上)	>8000 VAC@1mmT	ASTM D149
结构&成份	陶瓷填充硅橡胶	*****	介电常数	5.5 MHz	ASTM D150
导热率	2.5 W/mK	ASTM D5470	体积电阻率	7.8X10 ¹³ Ohm-cm	ASTM D257
防火等级	94V0	E331100	使用温度范围	-20-200 °C	*****
比重	2.87 g/cc	ASTM D297	总质量损失 (TML)	0.55%	ASTM E595

TIF100 - 25

产品型号

导热率: 2.5W/mk



罐装:

- 可在75毫升, 180毫升, 360毫升和600毫升的胶盒
 - 可在20公斤桶
- 如需不同罐装请与本公司联系。

如果您想了解更多导热材料的产品信息, 请访问我司官网: <http://www.ziitek.com>



导热灌封胶 | 相变材料 | 导热砂胶布 | 导热膏 | 导热双面胶 | 导热硅胶片 | 陶瓷散热片 | 石墨片 | 导热塑料

加拿大:
Tel: +001-604-2998559
E-mail: sales@thermazig.com

台湾:
Tel: +886-2-22771007
Fax: +886-2-22771075
E-mail: jerry@ziitek.com.tw

东莞:
Tel: +86-769-38801208
Fax: +86-769-83791290
E-mail: angus@ziitek.com

昆山:
Tel: +86-512-57816297
Fax: +86-512-57816327
E-mail: kelvin@ziitek.com

成都:
Tel: +86-28-62379168
Fax: +86-28-62379168
E-mail: david_cd@ziitek.com

以上资料与说明相信是可靠的但不作为法律的解释或保证. 用户须进行充分的测试与确认上述讯息适合用户所提出任何特殊的产品与应用。